

gc6F13【秋田】機械設計・開発エンジニア（半導体製造装置/ウェハ搬送系ユニット）

TDK株式会社での募集です。 機械設計・機構設計・筐体設計・メカトロ設計・装置...

Job Information

Recruiter
JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company
TDK株式会社

Job ID
1620245

Industry
Electronics, Semiconductor

Job Type
Permanent Full-time

Location
Akita Prefecture

Salary
6.5 million yen ~ 11 million yen

Work Hours
08:30 ~ 17:00

Holidays
【有給休暇】入社7ヶ月目には最低10日以上 入社月によって試用期間終了後に付与される日数が異なり、次年度4月に21日が付与され...

Refreshed
October 29th, 2026 18:23

General Requirements

Career Level
Mid Career

Minimum English Level
Business Level

Minimum Japanese Level
Native Level

Minimum Education Level
Technical/Vocational College

Visa Status
Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2421083】
■お任せする職務内容
半導体製造装置のロードポートを中心としたウェハ・基板搬送系ユニットに関する機械設計をお任せいたします。

*仕事内容の変更範囲：会社の定める業務全般

■組織のミッション
ロードポートや実装装置を中心とした半導体装置事業を手掛ける事業部門において、ロードポート等のウェハ・基板搬送系ユニットに関する機械設計を担っています。

■募集背景
半導体装置市場でのシェア拡大・事業成長を図るべく、競争力ある製品・技術を生み出すためのエンジニアリソースの強化に向けた人員の増強。

■当業務の魅力点・応募者にとってのベネフィット
TDK＝部品メーカーというイメージが強い方も多いかと思いますが、我々の部門は半導体製造装置を製造・販売しています。手掛けているロードポートを中心としたウェハ・基板搬送系ユニットは半導体製造装置には不可欠でAIエコシステムの構成要素のひとつとして今後も伸長が見込まれ、当部門はTDKの成長事業と位置づけられています。この事業成長を果たし、半導体業界・TDKのなかでなくてはならない存在となるべく、ともにプロアクティブに行動いただける方の応募をお待ちしております。

Required Skills

■必須要件
・装置設計の実務経験3年以上

■歓迎要件
・半導体製造装置の設計の実務経験
・英語力：資料作成やメール等文面の読み書きが行えるレベル（目安：TOEIC 600/CEFR B1）

Company Description

■受動部品：セラミックコンデンサ、インダクティブデバイス、高周波部品、圧電材料部品、回路保護部品、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ■センサ応用製品：温度センサ、圧力センサ、磁気センサ、MEMSセンサ■磁気応用製品：マグネット、高性能磁気ヘッド、HDDヘッド用サスペンション■エナジー応用製品：エナジーデバイス、電源（産業機器用、xEV向け車載用など）■その他：フラッシュメモリ応用デバイス、電波暗室、FA機器